

## 三星傳投資越南逾 8 億美元 擴大 FC-BGA 載板產能

資料蒐集：經濟日報

在全球晶片短缺預計會持續到明年之際，知情人士透露，被動元件大廠三星電機應對的方式是提高生產 IC 載板的資本支出。

韓國時報報導，三星電機的強項是生產印刷電路板，消息人士透露，三星電機計劃投資約 1 兆韓元（8.4 億美元）至越南的生產設施，以增加覆晶球閘陣列（FC-BGA）載板的產量，「三星電機管理階層對加大投資 FC-BGA 一事，達成普遍的共識。然而，目前三星對新投資案的地點尚未有定案，但選在南韓的可能性較低」。消息人士還說，三星電機計劃讓越南廠停止生產老式射頻元件載板。

根據消息人士的說法，三星電機有意擴大 FC-BGA 產能的計畫，已吸引英特爾、超微等科技大咖的目光，「在晶片持續短缺的帶動下，使用 FC-BGA 封裝技術的進階載板需求，將持續暢旺好幾年，而這意味著英特爾、超微（AMD）等頂尖晶片公司，可能會搶先與載板廠敲定預先採購協議，甚至提供財務援助，以生產客製化的載板」。